シリコンスラッジを用いたシリサイド系熱電変換材料の開発

山本佳嗣*,井上幸司*,稻垣順一**,田口 豊***,

阪西浩志***,山本 彬***,野出明奈***

Development of Silicide Type Thermoelectric Material with Si Sludge

Yoshitsugu YAMAMOTO, Koji INOUE, Jun-ichi INAGAKI, Yutaka TAGUCHI, Koji SAKANISHI, Akira YAMAMOTO and Akina NODE

Silicon sludge formed in cutting Si wafers was recycled as a source of Si, and Mg₂Si powder was synthesized with the sludge-derived Si. The synthesized powder was sintered by a spark plasma sintering technique, and then processed to the thermoelectric material. From measurement of Seebeck coefficient, it was found that the material had n-type thermoelectric ability, and that the sludge-derived Mg₂Si has higher power factor than the reagent-base one.

Key words: Silicon Sludge, Magnesium Silicide, Thermoelectric Material, Seebeck Effect, Use of Energy

1. はじめに

半導体デバイス用シリコン(Si)ウェハーは, 円柱状の単結晶Siインゴットを円盤状にスライス して作製される.その際,切り代にあたる部分は 全量のおよそ半分程度に相当し,切り屑として発 生する汚泥(Siスラッジ)は通常,産業廃棄物と して処理される.我々はこれまでの研究において, フィルタープレスによる加圧濾過及び後洗浄工程 によって,Siスラッジに含まれる不純物を除去し, Si 粉末原料として再利用する手法の開発に取り組 んできた¹⁾.

一方で,近年,省エネルギーや低炭素社会の実 現といった観点から,エネルギー関連の技術開発 が盛んに行われている.中でも,熱エネルギー(温 度差)から電気エネルギーを取り出す熱電変換技 術は,幅広い分野への展開が見込まれ,特に注目

- ** 窯業研究室
- *** 株式会社安永

すべき技術である²⁻⁴⁾. 各種エネルギーを利用する と、その大半は排熱として廃棄される. 特に低温 ~中温領域(100℃以下~600℃程度)に相当する 排熱はあらゆる場所に分散して存在しているが、 ほとんどが未利用のままであり、これらの有効活 用は非常に重要な課題である. 中温領域(200~ 600℃程度)の排熱を効率的に電気エネルギーに変 換しうる材料として、シリサイド系材料が挙げら れる⁵⁻¹⁶⁾. 中でもマグネシウムシリサイド(Mg2Si) は、存在量が豊富なマグネシウム(Mg)と Si か らなる安全・無害な無機化合物であり、かつ軽量 であることから^{9,10)}、自動車等の移動体に組み込 みやすいなど、分散する中温排熱の利用に適した 実用可能性の高い材料である.

そこで、本研究では、Si スラッジ由来の Si 粉末 を原料に用い、マグネシウムシリサイド熱電変換 材料を作製することを目的とした.特に、実用化・ 事業化を視野に入れた中規模での材料合成手法を 検討し、焼結体素子の作製及び得られた素子の熱 電特性評価を行ったので報告する.

^{*} プロジェクト研究課

2. 実験方法

可能となる 10,11).

2. 1 Mg₂Si 粉体合成

ラボスケールによる予備実験 2.1.1 市販のMg粉末(純度>98.0%)とSi粉末(純 度> 99.9%, ~5 µm) を mol 比 2:1 となるよう 秤量し,乳鉢またはボールミルを用いて混合した. 得られた混合物を 5~15 g 程度の所定量, アルミ ナ製 B1 坩堝(内径 46 mm×高さ 36 mm, 容量 30 mL) に入れ、アルミナ製の蓋で覆った. また この際, Mg の蒸散や酸化を抑えることを目的と し、耐熱ボンドを用いて蓋を接着し、坩堝内を密 封することも検討した. 坩堝を雰囲気制御可能な 電気炉 (ADVANTEC 製 FUA112DB) に入れ、 約 0.06 MPa の低圧アルゴン (Ar) 雰囲気下, 900 ~1150℃の温度で数時間,熱処理を行った.これ により、Mgが坩堝内で融解し、Mg浴中にSiが 溶解することで液相反応が進み, Mg2Siの合成が

冷却後,得られた試料を乳鉢で粉砕し,X線回 折測定(XRD(Rigaku 製 Ultima IV 及び RINT2500))により合成物の同定を行った.

2.1.2 粉体合成のスケールアップ実 験

実用化・事業化を視野に入れ、規模を拡大して 粉体合成を試みた.バッチ量 250g での合成が可 能となるよう、大型のアルミナ製坩堝及び蓋を作 製した. 坩堝胴部には, SSA-H T8 タンマン管(内 径 50 mm,高さ 180 mm,容量約 350 mL)を用 い、同タンマン管の底部を高さ 60~70 mm とな るよう切断加工したものを蓋として用いた. Si源 としては、市販のSi塊状体原料(純度>99.9999%、 4 mm 以下), または Si スラッジ由来の Si 粉末 を用いた. スラッジ由来 Si には微量の不純物元素 が含まれると考えられることから、誘導結合プラ ズマ発光分光分析(ICP(SII 製 SPS5510))を 用いて微量元素の測定を行った.測定結果の一例 を表1に記す. Mg 源には市販の Mg 金属片(純 度 99.93%, MG-10 規格品)を使用した. これら に加え、キャリア濃度を増大し熱電性能を向上さ せることを目的として, Sb を添加した 15). Sb 源 には市販の Sb 塊(純度 99.9%, < 10 mm)を用 いた. Sb の添加を 0.5 wt%とし、仕込み組成 Mg 66.67: Si 32.83: Sb 0.5 となるよう秤量・混合し て大型坩堝内に入れ、熱処理を行った、熱処理に

表1 スラッジ由来 Si 中の微量元素

元素	濃度(ppm)	
Al	16.4	
Ca	138.7	
Cu	9.6	
Fe	60.6	
Κ	178.7	
Mg	23.6	
Mn	0.2	
Ni	22.9	
Sn	13.1	

は高温雰囲気炉(富士電波工業製ハイマルチ 10000)を用い,密封系にて Mg の蒸散や酸化を 抑えながら,約0.06 MPa の低圧 Ar+水素(H₂) 雰囲気下,1100~1300℃で7時間以上,熱処理 を行うことで Mg2Si の粉体を合成した.

一方で、合成物の組成均質性改善を目的とし、 Mg-Si 相平衡図をもとに、合成手法の再検討を行った. Mg-Si 相平衡図を図1に記す. Mg:Si=2: 1のモル比に相当する位置は1本の直線からなっ ており. 固溶幅を持たないラインコンパウンドと なっている⁹⁾. このことから、Mg と Si を十分に 融解反応させた後、一方向から固化することで、 均質な Mg2Si が得られると推測し、温度勾配を付 けて凝固することを試みた. 一方向凝固を行うに 当たっては、合成炉内が約10~15℃/cm の温度勾 配の付いた温度分布で固化できるよう、上下のヒ ーター温度を調整した. 市販の Si 源を用いる際に はバッチ量を250 g、スラッジ由来の Si 粉末を用 いる際には180 g として大型アルミナ坩堝に投じ、



図 1 Mg-Si 相平衡図

高温雰囲気炉の炉内雰囲気を一旦真空としてから Ar で置換した.保持温度を1150℃として20時間 保持し,その後-10℃/時の速度で坩堝下部から一方 向凝固を行った.合成した Mg2Si を,市販のSi 源を用いたものでは坩堝上部,中部,下部の3種 に分け,スラッジ由来のSi粉末を用いたものでは, 不純物を除去する目的で坩堝上部は除き,中部, 下部をまとめて採取した.

得られた合成原料を粉砕,分級した後,その後の評価(蛍光X線分析(XRF),XRD)及び放電 プラズマ焼結試験に供した.

2 放電プラズマ焼結法による焼結 試験

上記,中規模合成実験により得られた Mg2Si 粉体をさらに微細に粉砕し,放電プラズマ焼結装 置(富士電波工機製 SPS-1050)を用いて焼結試 験を行った^{16,17)}.粉体試料を直径 30 mm のグラ ファイトダイスに投入し,上下をグラファイトパ ンチで加圧しながら高周波のパルス通電を行うこ とで,試料に自己発熱を生じさせ,高速加熱が可 能となる.本試験では,パンチに 30~50 MPa の 圧力を加えながら,200℃/min で目的温度まで高 速昇温し,15 分保持した後冷却することで焼結体 を得た.焼結温度は,市販の Si 源を用いたもので は 870℃,スラッジ由来の Si 粉末を用いたもので は 860℃に設定した.得られたバルク焼結体を, ワイヤソーを用いて所定のサイズ及び形状に切削 し,種々の測定に供した.

2.3 熱電特性評価

放電プラズマ焼結により得られた焼結体試料を 2×2×8 mmの直方体に切削し,熱電特性評価試 験に供した.熱電特性の評価には ULVAC 理工製 の ZEM-3 を用い,試料のゼーベック係数,導電 率,電力因子を測定することで行った.ゼーベッ ク係数 S [V/K]は試料内の高温部と低温部との温 度差 ΔT[K]と,その温度差により高温部と低温部 間に発生する電位差 E[V]を用いて $S=E/\Delta T$ で表 される.また電力因子はパワーファクターとも呼 ばれ,ゼーベック係数 Sと導電率 σ を用いて $S^2\sigma$ で表される.いずれも、材料の熱電特性を示すパ ラメータの一つである ⁴.

2. 4 焼結体素子への電極接合試験

熱電変換モジュールを構築する際には,素子-導線間の接触抵抗を低減させるため,素子の上下 を金属化する等して電極形成を行うことが望ま れる. そこで, 放電プラズマ焼結により得られた Mg2Si 焼結体試料に対し、その上下に金属 Ni 箔 を配し,再度放電プラズマ焼結を行うことで拡散 接合により Ni 電極を形成することを試みた. 拡 散現象により異種材料を接合するには、両材料界 面を接触した状態にした上で,両材料が拡散可能 な温度で一定時間保持する必要がある.この際, 接触状態を確保する事が重要になると考えられる ことから, 焼結体試料と Ni 箔の接触状態の確保に 着目し, 試料表面の面粗度, 放電プラズマ焼結時 の圧力、及びグラファイトダイスへのセッティン グ方法を因子として変化させ、接合試験を実施し た. 直径 30 mm の Mg₂Si 円盤状焼結体試料の上 面及び下面に同サイズの Ni 箔を置いてグラファ イトダイスにセットし、その上下をグラファイト パンチで挟んで 5,7,及び 15 MPa の圧力を加え ながら800℃で10分間の放電プラズマ焼結を行っ た. なお, 圧力を 15 MPa とした際には, グラフ ァイトパンチと Ni 箔の間に同サイズのグラファ イトペーパーを挿入した. グラファイトペーパー は、パンチと円盤状試料表面のうねりを相殺し、 試料表面全体に Ni 箔を押し付ける役割を果たす. 表2に接合試験条件を纏める.

接合後,ワイヤソーにより試料を直方体素子状 に切断し,電極のテープ剥離試験を行った.テー プ剥離試験は,JIS K 5600-5-6「塗料一般試験方 法-塗膜の機械的性質-付着性(クロスカット

円盤状試料	の表面状態	接合時の条件		剥離の有無	
処理方法	面粗度 Ra	圧力	カーボンペーパー	接合直後	熱処理後
ワイヤソーカット	0.7 μm	5 MPa	無	無	<u>有</u>
ワイヤソーカット	0.7 µm	7 MPa	無	無	<u>有</u>
研磨	0.022 µm	15 MPa	有	無	無
研磨	0.033 µm	$15 \mathrm{MPa}$	有	無	無

表 2 Ni 電極接合試験条件と剥離試験結果

法)」¹⁸⁾ に準じて行い,切込み工具にはマルチワ イヤソーを,付着テープには住友スリーエム製両 面テープ KPP-19 をそれぞれ用いた.試験は,素 子作製直後と,素子を大気雰囲気中 600℃で 24 時 間熱処理した後に行った.

3. 結果·考察

3. 1 Mg₂Si 粉体合成

3.1.1 ラボスケールによる合成

アルミナ坩堝にアルミナ蓋を被せ,900℃で4時間,熱処理を行った試料の外観を図2に示す.坩 堝下部には Mg2Si と見られる青黒色の塊が得られた.一方で,坩堝の上部には黒灰色の部分が見ら



図 2 小型アルミナ坩堝中,900℃で 合成した試料の外観



図 3 小型アルミナ坩堝中,900℃で合成した試料 の XRD パターン(上:坩堝上部,下:坩堝下部)

れた.各々の部分の XRD 測定結果を図 3 に示す. 坩堝下部はほぼ単相の Mg_2Si となっているのに対 し、坩堝上部からは酸化マグネシウム (MgO) と Si が検出された.これらのことから、炉内に残存 する酸素により Mg が酸化されていること、及び 反応が十分に進んでいないことが示唆されたた め、耐熱ボンドを用いてアルミナ蓋を坩堝に接着 することで Mg の酸化を抑え、かつ熱処理温度を 1000~1100Cまで上げ、合成反応をより進めるこ とを試みた.得られた試料の外観を図 4 に示す. 灰色部分は存在せず、金属光沢を持つ青黒色の塊 状体が得られた.XRD 測定の結果から(図 5), Mg_2Si が単相で存在していることが確認され、Mg



図 4 アルミナ坩堝と蓋を接着し, 1100℃で合成した試料の外観



図 5 小型アルミナ坩堝と蓋を接着し、1000℃で 合成した試料の XRD パターン

の酸化を抑えながら Mg_2Si を合成することに成功 した.

3.1.2 スケールアップ実験による中 規模合成

Si 源に市販の Si 塊状体原料を用い, バッチ量 250gを大型のアルミナ製坩堝に入れて蓋をし、 高温雰囲気炉により熱処理を行った試料の外観を 図6に示す.金属光沢を持つ青黒色の塊状体が得 られたが、坩堝上部には MgO と思われる白色の 塊状体が生じる等, 合成物の組成均質性に疑問が 残る結果となった.このことから、組成均質性を 改善するため, Mg-Si 相平衡図をもとに合成方法 の再検討を行い、一方向凝固による合成を行った. 市販のSi 塊状体原料をSi 源とし、一方向凝固に より合成した試料の外観を図7に示す. 坩堝上部 は、表面に MgO と思われる白色物質の偏析が見 られ、中部、下部については Mg₂Si 特有の青黒色 の劈開面が観測された. これらの試料の XRD パ ターンを図8に示す. 坩堝上部ではMg2Si以外に Al や Si のピークが観測されたが、MgO のピーク は観察されなかった.一方坩堝中部,下部におい ては Mg₂Si に帰属されるピークのみが観測され た. Al は Mg により還元されたアルミナ坩堝に由 来するものと考えられ、これが一方向凝固により 上方へ偏析したものと考えられる. 同様に、合成 過程において一部未反応のまま残留した Si も坩 堝上部に偏析したものと思われる.

スラッジ由来の Si を Si 源として合成した試料 の外観を図 9 に示す. 坩堝上部には灰色や褐色の 部分が目立ち,これらは後工程の焼結に影響する ものと考え除去した. 坩堝中,下部では,市販の Si 塊状体原料を用いたときに見られた劈開面は観 測されなかった. 図 10 に,坩堝中,下部を混合し て得られた試料の XRD パターンを示す. Mg2Si 以外に, MgO, Mg2SiO4に帰属されるピークが観 測された. スラッジ由来の Si は処理過程で表面が 一定程度酸化されていることが想定され,これが 酸素源となって原料を酸化させたものと考えられ る.

3.2 XRFによる元素分析

市販の Si 塊状体原料及び Si スラッジ由来の Si 粉末を用いて中規模合成した Mg₂Si について, XRF (Rigaku 製 ZSX Primus II)を用いて組成分 析を行った. 測定結果を表 3 に示す. Si スラッジ



図 6 スケールアップ試験により合成 した試料の外観



図 7 一方向凝固により合成した試料 の外観



図 8 一方向凝固により合成した試料の XRD パターン



図 9 Si スラッジを用い, 一方向凝固により合成 した試料の外観





由来の Mg2Si には,市販 Si 由来のものに比べ,不 純物として Na や Mn, In 等の元素が微量に混入 していることがわかった.これらは主にスラッジ 中に含まれる不純物元素であると思われ,スラッ ジ洗浄時の洗浄剤等から混入した可能性が考えら れるが,洗浄方法やロットの違いによってバラツ キがあり,混入源の詳細は不明である.なお合成 時の坩堝上部における着色物質はこれらの不純物 によるものと考えられる.

3.3 放電プラズマ焼結法による焼結 試験

市販の Si 塊状体原料を Si 源とし,一方向凝固 により得られた Mg2Si 粉末を用いて焼結した試料



図 11 焼結体試料の外観

の外観を図11に示す.坩堝上部を用いた試料では, 作製試料のほぼ半数にクラックが生じ,また焼結 時に融液の漏れが生じた.坩堝中部,下部を用い た試料では,いずれもクラックは発生せず,安定 的に焼結体を得ることができた.このことから, 一方向凝固により品質の安定した Mg2Si 原料の合 成が可能となり,焼結体も容易かつ安定的に得ら れることが分かった.

また,スラッジ由来の Si を Si 源とした原料を 用いても,同様の条件で焼結体を得る事ができた.

3. 4 Mg₂Si 焼結体の熱電特性評価

放電プラズマ焼結法により得られた無ドープ Mg2Si 焼結体,及びドーパントとして Sb をドー プし,市販 Si 及びスラッジ由来の Si を用いて作 製した Mg2Si 焼結体のゼーベック係数測定結果 を図 12 に示す.ゼーベック係数が負の値を示し ていることから,導電キャリアとして電子が寄与 するn型の熱電変換能を有することが確認された. Sb をドープした試料では,Si 源に関わらず,雰 囲気温度に依存して直線的に係数の絶対値が大き くなっており,無ドープ試料に比べ係数の絶対値 が低くなった.この挙動は,過去の報告ともよく 一致している¹⁵⁾.また,スラッジ由来の Mg2Si では,市販 Si を用いたものと比べ係数の絶対値が 全温度領域にわたって若干低くなっていた.図13,

市販 Si 由来 Mg ₂ Si		Si スラッジ由来 Mg ₂ Si		
成分	組成比(wt%)	成分	組成比(wt%)	
Na	_	Na	0.01	
Mg	52.13	Mg	53.32	
Al	0.81	Al	0.14	
Si	41.79	Si	40.73	
Р	< 0.01	Р	< 0.01	
S	0.01	S	0.01	
Ca	0.04	Са	0.01	
Mn	_	Mn	0.01	
Fe	0.01	Fe	0.02	
Ni	0.01	Ni	0.01	
Cu	0.01	Cu	0.01	
Zn	< 0.01	Zn	< 0.01	
In	_	In	0.02	
Sn	0.15	Sn	0.15	
Sb	5.06	Sb	5.57	

表3 市販 Si 及びスラッジ由来の Si を用いて作製した Mg₂Si の元素分析結果(XRF・FP 法による半定量)

14 に, これらの試料の導電率と電力因子の測定結 果をそれぞれ示す. 導電率は, 全温度領域にわた ってスラッジ由来の Mg2Si が最も高い値を示し, 無ドープのものが最も低い値を示した. Sb をドー プしたものは無ドープのものと比べ, 300℃以上 の温度領域で電力因子の値が高くなっており, Sb のドープは中温排熱向けの熱電変換素子作製に有 効であることが確認された. また, スラッジ由来 の Mg2Si は市販 Si 由来のものより全温度領域に わたって電力因子が高く, 優れた性能を示した. XRF 及び XRD の結果から, スラッジ由来の Mg2Si には僅かながら不純物が混入されており, これが試料の電気抵抗を引き下げ, 熱電特性に影 響を与えていることが考えられる.

熱電変換素子としての能力を評価する際には、 ゼーベック係数によって表される熱電能だけでな く,熱伝導率 κ [Wm⁻¹K⁻¹]と導電率 σ [Sm⁻¹]及び温 度 T[K]を介した無次元性能指数 $ZT=S^2\sigma T/\kappa$ を用 いることが多い²⁾. すなわち,実際に熱電発電を 行うためには、高い熱電能の他に、電流を取り出 すための高い導電率と、温度差を保つための低い 熱伝導率を確保する必要がある.よって今後、他 の物性値をも測定し、試料の性能指数を見積もっ たうえで、熱電変換材料としての利用可能性を追 求していきたい.

3.5 焼結体素子への電極接合試験

Mg₂Si 焼結体に接合した Ni 箔電極のテープ剥 離試験結果を表 2 に示す.いずれの試料も,接合 直後の試験では電極の剥離は見られなかったが, ワイヤソーでカットした表面(Ra 0.7 µm)を持 つ試料を,圧力 5~7 MPa,グラファイトペーパ 一無しの条件で処理した試料では,600℃で 24 h の熱処理後,剥離試験により電極が剥離し,電極 の密着強度が不十分であることがわかった.その 外観を図 15 に示す.電極剥離が見られる部位と 見られない部位が顕著に分かれており,接合処理 中の Mg₂Si と Ni 箔の接触状態が部位により大き く異なる可能性が示唆された.

表面を研磨し面粗度を小さくした試料(Ra 0.022~0.033 µm)を, 圧力 15 MPa, グラファ イトペーパー有りの条件で処理した試料では, 600℃で 24 時間の熱処理後でも剥離試験による 電極の剥離は発生しなかった.このことから, 試 料の面粗度と押し付け圧力, グラファイトペーパ 一挿入による表面うねりの相殺が, Mg2Si と Ni 箔の接触状態を改善し, 電極の接合に有効に働く ことが分かった.

4. まとめ

Si ウェハー切削時に発生する Si スラッジを Si



図 12 Mg2Si 焼結体のゼーベック係数測定結果



Temperature / °C

図 13 Mg₂Si 焼結体の導電率測定結果



Temperature / °C

図 14 Mg₂Si 焼結体の電力因子測定結果



図 15 テープ剥離試験後, 電極の剥離が見ら れた試料の外観(上:剥離した部位, 下:剥離しなかった部位)

粉末原料として再生し,市販の Mg 原料とともに 熱処理を行うことで, Mg2Si 熱電変換素子を作製 することを試み,以下の結果を得た.

 ・Si スラッジを Si 源とし、一方向凝固により Mg2Siの合成を行ったところ、部分的に着色や酸 化が見られたが、Mg2Siを主相として合成するこ とができた.一方で、市販の Si 塊状体原料を Si 源とし、同様の合成を行った場合は、Mg2Siを単 相で合成できることが確認された.

•Si 源を変えて合成した各 Mg2Si 粉末を放電プラ ズマ焼結したところ,いずれも安定的に焼結体を 得ることができた.

・得られた焼結体の熱電特性を評価したところ, Si スラッジ由来の焼結体は市販 Si 由来のものと 比べ,全測定温度領域に渡ってゼーベック係数の 絶対値は低くなり,導電率と電力因子は高くなっ た.

・放電プラズマ焼結を用いて、拡散接合により Mg₂Si に Ni 箔電極を形成することを試みたとこ ろ、Mg₂Si と Ni 箔の接触状態を改善することで 接合強度を向上させられることがわかった.

今後,熱伝導率等の物性を評価し,熱電性能指 数を見積もることで,熱電変換材料としての利用 可能性を追求したい.

参考文献

- 1) 稲垣順一ほか: "シリコンスラッジのリサイク ル技術の開発". 三重県工業研究所研究報告, 36, p115-117 (2012)
- 河本洋: "排熱回収用高効率熱電変換材料の研究開発動向". 科技政策研・科学技術動向 No.90 (2008 年 9 月号) レポート 2
- 3) 舟橋良次ほか: "熱電発電を利用した小型コジ エネシステムの開発". Synthesiology, 1(2), p94-100 (2008)
- 5) 柄木田充宏ほか: "8-FeSi2 のホットプレスに よる合成と焼結及びその熱電特性". J. Jpn. Soc. Powder Powder Metallurgy, 55(11), p776-780 (2008)
- 6) Y. Noda et al., "Temperature Dependence of Thermoelectric Properties of Mg₂Si_{0.6}Ge_{0.4}". Mater. Trans. JIM, 33(9), p851-855 (1992)
- 7) Y. Niwa et al. : "Thermoelectric Properties of Ca-Mg-Si Alloys". Mater. Trans., 50(7), p1725-1729 (2009)
- 8) 佐野精二郎ほか: "高効率熱電発電システムの 開発". コマツ技報, 49(152), p20-26 (2003)
- 飯田努: "環境低負荷型 Mg₂Si による排熱発電 モジュールの開発の現状".日本熱電学会誌, 6(2), p13-17 (2009)
- 10) 丹羽陽亮ほか: "Na 添加 Mg₂Si の熱電特性". 日本金属学会誌, 72(9), p693-697 (2008)
- 11) 松野光晴ほか: "液相-固相反応法によるマ

グネシウムシリサイド化合物の合成とその熱電 特性".粉体および粉末冶金,56(1),p26-29 (2009)

- 杉山明ほか: "メカニカルアロイングおよび パルス通電焼結を利用した Mg2Si-MnSi1.73 熱電 材料の作製".日本金属学会誌, 64(5), p355-358 (2000)
- 13) 杉山明ほか: "メカニカルアロイングを利用 した Mg2Si 基複合熱電材料の作製". 粉体およ び粉末冶金, 45(10), p952-957 (1998)
- 14) K. Kim et al.: "Synthesis Characteristics and Thermoelectric Properties of the Rare-earth-doped Mg₂Si System". J. Korean Phys. Soc., 57(4), p1072-1076 (2010)
- 15) J. Tani et. al.: "Thermoelectric Properties of Sb-Doped Mg₂Si Semiconductors ". Intermetall., 15, p1202-1207 (2007)
- 16) 坂之上悦典ほか: "環境対応型熱電変換素子 材料の廃熱利用可能性について".京都府中小企 業技術センター技報, 38, p37-41 (2010)
- 坂之上悦典ほか: "Mg2Si 粉体の合成に関する研究(人に優しい環境に優しい次世代医療材料の開発(IV))".京都府中小企業技術センター 技報,37,p33-37 (2009)
- 18)日本工業規格: "塗料一般試験方法-第5部:
 塗膜の機械的性質-第6節:付着性(クロスカット法)".JIS K 5600-5-6:1999

(本研究は,産業廃棄物抑制型共同研究事業により実施しました.)